

# 华龙投顾掘金

## 投顾周报

题目：磨底阶段 保持耐心

### 一、上周市场概况

上周行业板块涨幅居前的有房地产、建筑装饰、农林牧渔、轻工制造、商贸零售等；行业板块跌幅居前的有通信、计算机、传媒、电子、电力设备等。本周行业板块主力资金净流入居前的有房地产、食品饮料、商贸零售、基础化工、汽车等；行业板块主力资金净流出居前的有计算机、电力设备、通信、国防军工、公用事业等。

上周沪指震荡下行，均线再度空头排列，五日均线对股指形成反压，弱势特征明显；两市成交量萎缩至 7000 亿水平，表明市场活跃资金越来越少，是市场信心严重不足的体现。从市场特征看，市场畏高情绪大幅升温，前期强势板块纷纷大幅补跌；而轮动的方向主要切换到低位、此前关注度不高的行业，部分超跌低价股表现强劲，既有博弈政策的因素，又有高低切换的特征。上周中央发布关于促进民营经济发展壮大意见，无奈市场已经到了无视利好的阶段。总体来说，当前股指大概率处于震荡筑底阶段，其过程却让很多投资者备受煎熬；随着美国七月加息落地以及国内的政策利好的累积，市场大或逐步明朗，要相信一切都会慢慢好起来的，毕竟从长期角度讲，沪指 3100 多点机会或大于风险；当前适合耐心等待，切勿盲目追涨杀跌。从北向资金流向来看，上周累计净卖出 75.25 亿元，其中沪股通净卖出 57.02 亿元，深股通净卖出 18.23 亿元。



## 二、宏观部分

事件：财联社7月19日电，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见指出，加大对民营经济政策支持力度，精准制定实施各类支持政策，完善政策执行方式，加强政策协调性，及时回应关切和利益诉求，切实解决实际困难。

评论：今年以来，我国经济总量稳步恢复，结构持续改善，但在内需不足、外需下行、房地产持续低迷的环境下，稳增长、稳就业的压力依然较大。近期，国家统计局公布的2023年上半年经济数据显示，上半年GDP增速为5.5%，两年的复合增速4.0%，其中今年二季度在同期基数较低的情况下增速6.3%；另外6月青年失业率进一步上升为21.3%，已经连续5个月呈现上升状态。过去通过房地产就能拉动内需的核心抓手现在已经不适用了，国家层面也在不断通过政策引导，通过调结构，推动国民经济高质量发展。高质量发展离不开民营经济，离不开民营企业科技创新的潜力；民营企业的数量占比达到九成，吸纳了八成左右的就业，还有很多的专利技术，有着举足轻重的地位。国家层面历来非常重视发展民营经济，通过深度调研，并结合当前中小微企业遇到的各种压力、困难，及时发布了指引性的意见；通过顶层设计，层层推进，增强中小企业的信心和活力，意义重大。《意见》开篇指出，民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。《意见》提出了支持民营经济的总体要求，内容包含了7大方面31条具体措施，主要包括：持续优化民营经济发展环境、加大民营经济政策支持力度、强化民营经济法治保障、着力推动民营经济实

现高质量发展、促进民营经济人士健康成长、持续营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围、加强组织实施等。内容很详实，回应了民营企业和民营企业家的关切，具有明确的指引性。《意见》发布之后，不少知名民营企业企业家也纷纷表示将坚定不移的办好企业，走高质量发展之路。对于股票市场来说，虽然暂时还没有看到明显的反馈，但随着未来配套工具的陆续推出，必然会带来经济数据以及就业压力改善的预期。

### 三、国际方面

事件：财联社 7 月 19 日电，受英伟达等 HPC 客户订单旺盛影响，台积电 CoWoS 先进封装产能吃紧。

评论：先进封装是指将芯片和 SMT 元件组合到系统级封装（SiP）应用中，将它们嵌入基板腔中，或者通过晶圆级扇出、或面板级扇出工艺将芯片的触点展开，以提升集成电路的连接密度和集成度，是属于前沿的封装形式和技术。当前，先进封装的市场规模超过 40%，随着 AI 需求的提升，同时也带动先进封装需求提升，其中 2.5D 封装、3D 封装的增速尤其突出。目前，英伟达 A100、H100 等人工智能 GPU 都是使用台积电的晶圆及其 2.5D 封装的前端工艺。CoWoS 是台积电独家的一种先进的半导体封装技术——2.5D 封装技术；这项技术的核心优势在于其能够在一个封装内集成多个功能模块，如处理器、内存等。它突破了传统集成电路设计的框架，通过缩短芯片间的互连距离，提升了产品性能与能效的同时降低了生产成本；其独特性使其在高性能计算、人工智能等领域展现出了广阔的应用前景。然而，台积电的现有产能无力承担所有 2.5D 封装工作量。日前也有报道指出，亚马逊 AWS、博通、思科和赛灵思等公司都提高了对台积电 CoWoS 封装需求，台积电正积极扩产 CoWoS。《科创板日报》近期也有报道说英伟达也与三星等公司开展洽谈。一系列事件表明，2.5D 等先进封装有订单外溢的可能，一方面 GPU 厂商可能会寻找替代方案，一方面台积电也存在将先进封测部分委外代工的可能。由于国内不少封测厂商早已具备先进封装技术，且具备技术升级及价格优势，A 股市场封测板块近期走势相对偏强，后续可以进一步留意相关事件的进展。

### 事件快讯

事件：本周市场出现了一种特殊的现象，高位股持续补跌、低价股受资金追捧。

评论：这种现象其实过去也曾经出现过，往往发生在市场极度低迷的时期，此次也不例外。其一，市场持续一段时间都缺乏主线，前期我们还可以看到 AI 细分、中特估、无人驾驶、机器人、汽车、新能源等板块之间的轮动，但随后轮动节奏逐渐加快，最终变成“轮不动”的状态，随之而来的还有高位股持续的补跌，不少短线参与者割肉离场，影响了活跃资金的参与热情；其二，此前披露的各项经济相关数据低于预期，股指也在持续走低，不少高位的公司纷纷披露减持计划，市场信心呈现越发不足的现象；其三，高位公司业绩预告大增的不少，真正超预期的并不多，而少量低价且中报预告大增的公司获得了资金的持续追捧，在市场关注度瞬间提升的效应下，带动了其他可

能有某种预期的低价股大涨。本身市场极度低迷的阶段，连续涨停的个股就很少，我们看到周五连续涨停个股中基本都是低价股，说明这种带动效应还是很明显。对于低价股，投资者需要注意的风险有：1、低价股大多基本面比较差，真正困境反转的公司少之又少，有些公司季报的业绩并不具备持续性；2、如果上市公司股价持续在1元以下，将会面临面值退市的风险；3、大部分低价股由于长期关注度较低，存在信息不够透明等其他的未知风险；4、根据以往经验看，大部分低价股阶段热炒之后，剩下的可能就是一地鸡毛，可能面临长期无人问津的风险，需要仔细甄别。

## 华龙证券

一级审核：徐富利 执业证书编号：S0230611030009

二级审核：姚浩然 执业证书编号：S0230623030002

责任编辑：张红 执业证书编号：S0230616110002

责任编辑：廖贻贤 执业证书编号：S0230620120001

### 免责声明

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本刊观点仅代表华龙证券观点，不构成具体投资建议，投资者不应将本刊作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本刊可取代自己的判断。相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，本公司对信息的完整性和真实性不做任何保证。股票价格运行受到系统和非系统风险的影响，请您客观评估自身风险承受能力，做出符合自身风险承受能力的投资决策。本刊物风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。据此操作，风险自负，因使用本刊物所造成的一切后果，本公司及相关作者不承担任何法律责任。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。